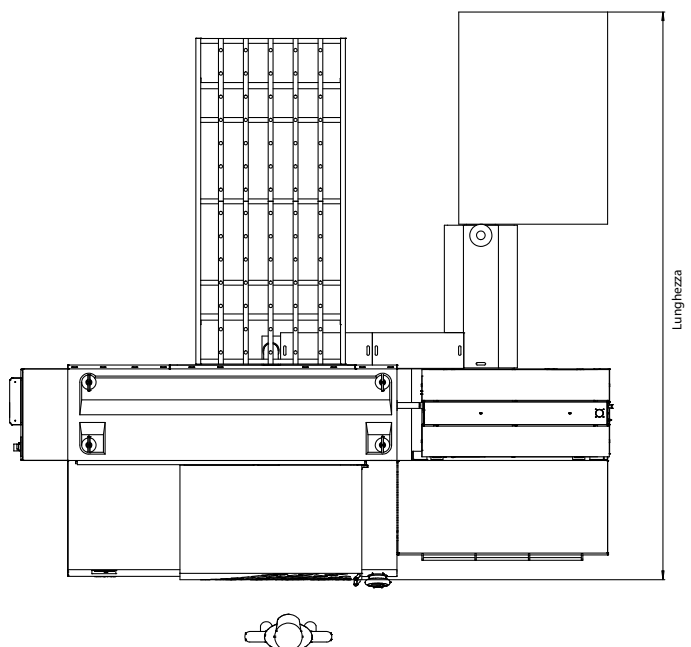
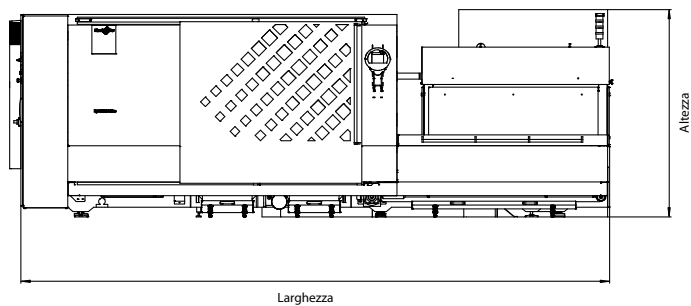


## Dati tecnici

### ByVention 3015

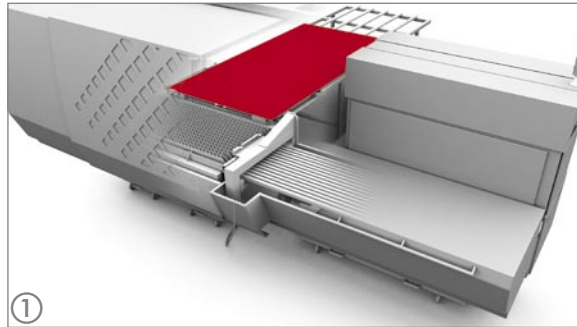


#### ByVention 3015

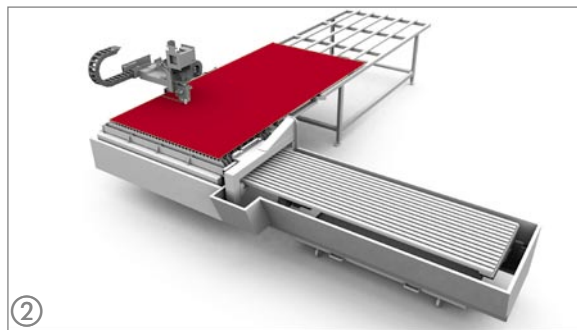
Potenza del laser	2200 W	4400 W
Lunghezza	6000 mm	6000 mm
Larghezza	6000 mm	6400 mm
Altezza	2150 mm	2150 mm

# Flusso del materiale innovativo

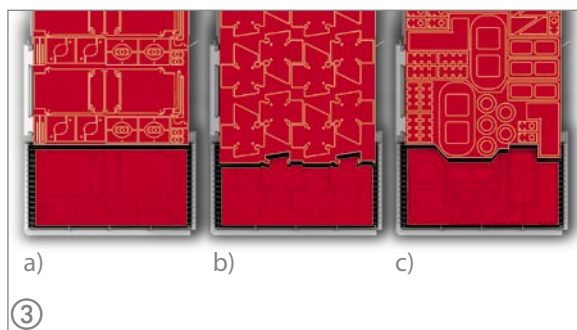
ByVention è il più piccolo impianto di taglio laser per formati standard di lamiera. Grazie all'intelligente e innovativo flusso del materiale, i pezzi vengono scaricati in modo continuo e automatico dall'area di taglio e sono dunque a disposizione dell'operatore già durante il processo di taglio. Il prelievo dei pezzi è semplice e comodo. La zona di prelievo è liberamente accessibile.



La lamiera viene collocata manualmente sulla tavola di carico e spinta fino alla battuta.



La lamiera viene introdotta automaticamente nell'area di taglio. Inizia la sequenza di taglio dei pezzi del primo segmento.



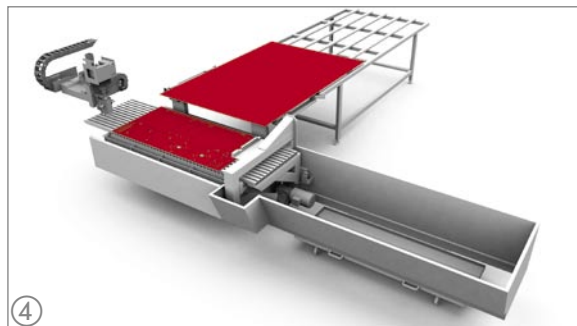
Con ByVention, la lamiera è suddivisa in segmenti che vengono tagliati in successione. Esistono **tre** diverse strategie di concatenazione dei pezzi sulla lamiera.

## a) Strategia senza sovrapposizione

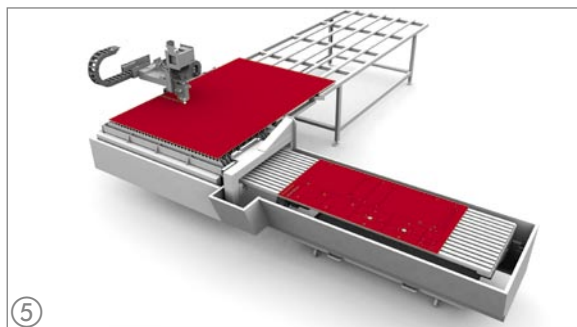
Questa strategia si presta per pezzi che possono essere concatenati in modo ottimale all'interno di un rettangolo. Prima di procedere al taglio dei pezzi, il segmento viene separato con un taglio rettilineo. La lunghezza massima del segmento corrisponde alla lunghezza del campo di lavoro, pari a 772 millimetri.

## b) Strategia con sovrapposizione e taglio di separazione parziale

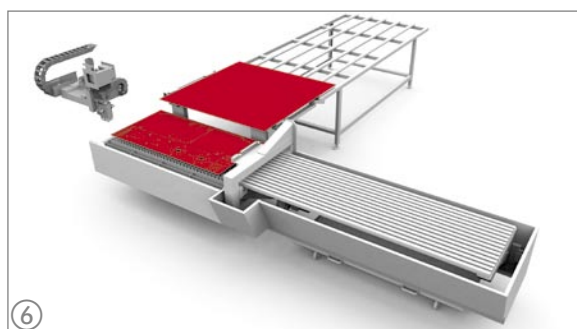
Questa strategia massimizza lo sfruttamento della lamiera quando i pezzi non possono essere concatenati in modo ottimale all'interno di un rettangolo. Il taglio di separazione segue in parte il contorno esterno dei pezzi e non è pertanto rettilineo. I segmenti risultano dentellati. I pezzi di un segmento si trovano tutti all'interno del segmento di 772 per 1562 millimetri.



Il segmento di lamiera tagliato viene scaricato automaticamente sulla tavola di prelievo.



La tavola di prelievo trasporta automaticamente il segmento di lamiera tagliato dall'area di taglio alla zona di prelievo. Nel contempo, la lamiera viene introdotta nell'area di taglio e inizia la sequenza di taglio del segmento successivo. I pezzi tagliati e la lamiera residua possono essere tolti manualmente dalla zona di prelievo.



Il secondo segmento di lamiera tagliato viene scaricato automaticamente sulla tavola di prelievo. Questo procedimento viene ripetuto fino a completare il taglio della lamiera. Non appena l'ultimo segmento di lamiera si trova nell'area di taglio è possibile collocare una nuova lamiera sulla tavola di carico.

Il software di taglio e di piegatura Bysoft di Bystronic supporta in modo ottimale i processi della ByVenton e se richiesto seleziona automaticamente la migliore strategia di segmentazione della lamiera durante la programmazione.

### c) Strategia con sovrapposizione e taglio di separazione completo

Questa strategia può essere utilizzata in alternativa alla strategia b), soprattutto per lamiere con uno spessore a partire da 3 mm e complesse geometrie dei pezzi o quando molti pezzi si trovano nella zona di sovrapposizione. Rispetto alla strategia b), qui il taglio di separazione è completo e avviene a una distanza definita lungo i contorni dei pezzi. Questo comporta un duplice vantaggio:

1. è necessaria un'unica perforazione, con un notevole risparmio di tempo in particolare con lamiere di forte spessore;
2. è garantita la massima sicurezza di processo anche in caso di particolari e concatenamenti complessi, nonché di lamiere più spesse.

Potenza del laser	2200 W	4400 W
Dimensioni nominali lamiera (lunghezza x larghezza)	3000 x 1500 mm	3000 x 1500 mm
	2500 x 1250 mm	2500 x 1250 mm
	2000 x 1000 mm	2000 x 1000 mm
Campo di lavoro	x = 1562 mm	x = 1562 mm
	y = 772 mm	y = 772 mm
	z = 100 mm	z = 100 mm
Velocità massima di posizionamento parallelo all'asse x, y	100 m/min	100 m/min
Velocità massima di posizionamento simultaneo	140 m/min	140 m/min
Scostamento di posizione Pa *	± 0,1 mm	± 0,1 mm
Banda di dispersione Ps *	± 0,05 mm	± 0,05 mm
Peso macchina **	13 500 kg	14 600 kg
Fondamenta	normale pavimento industriale armato secondo layout macchina	
Testa di taglio 5"	inclusa	inclusa
Testa di taglio 7,5"	opzionale	inclusa
Consumo gas di taglio	a seconda del materiale	
Comando	dispositivo di comando con schermo tattile	
Unità di lettura	interfaccia USB 1.1 sul dispositivo di comando manuale	
Allacciamento alla rete informatica	cavo RJ45 10/100 Mbit/s	
ByVision (specifiche tecniche: vedi scheda separata)	opzionale	opzionale

Sorgente laser CO <sub>2</sub>	ByLaser 2200	ByLaser 4400
Potenza	2200 W	4400 W
Lunghezza d'onda	10,6 µm	10,6 µm
Polarizzazione	circolare	circolare
Frequenza impulsi	1–2500 Hz	1–2500 Hz
Spessori massimi lamiera ***		
Acciaio	8 mm	8 mm
Acciaio inossidabile	6 mm	8 mm
Alluminio	4 mm	8 mm
Consumo elettrico dell'impianto ****	35 kW	54 kW

\* Secondo VDI/DGQ 3441, lunghezza di misura 1 m. La precisione dell'elemento tagliato dipende da materiale, pretrattamento del materiale, dimensione e surriscaldamento della lamiera.

\*\* Impianto di taglio laser completo, senza unità combinata di raffreddamento e filtro

\*\*\* Per tagliare gli spessori massimi devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Impianto di taglio laser regolato e sottoposto a manutenzione in modo ottimale
- I materiali devono essere conformi ai requisiti di qualità Bystronic (materiali per taglio laser)

\*\*\*\* Consumo caratteristico, compresa unità combinata di raffreddamento e filtro

Fatte salve variazioni dimensionali, strutturali e dell'equipaggiamento. Certificazione ISO 9001

## Il vostro contatto

[www.bystronic.com](http://www.bystronic.com)